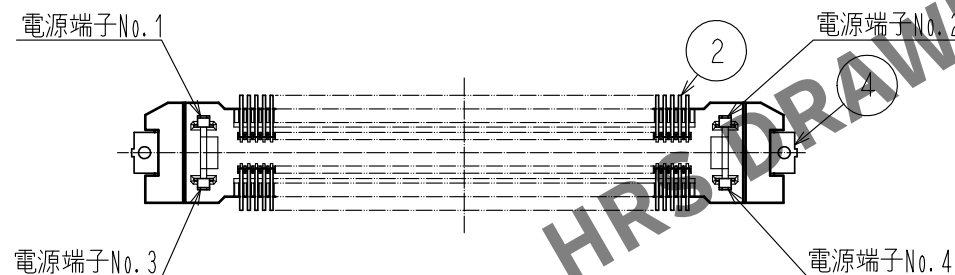
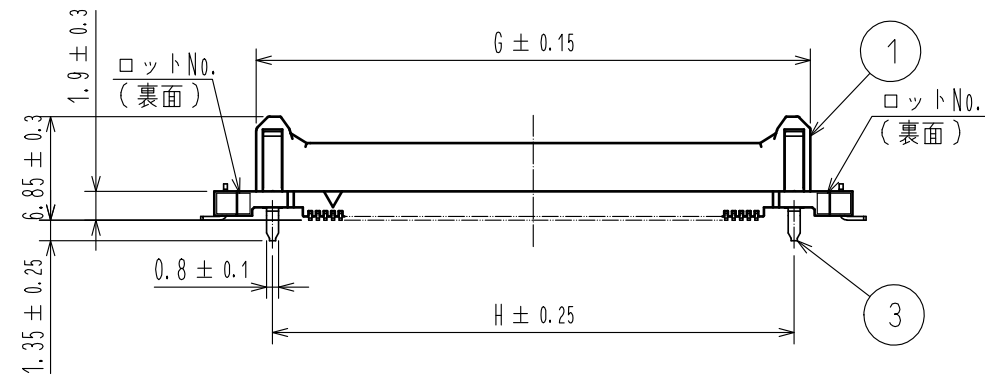
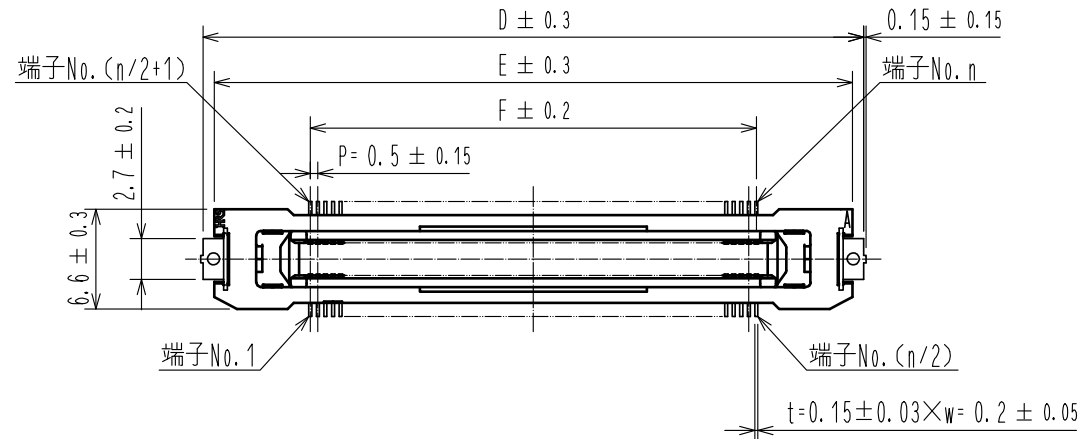
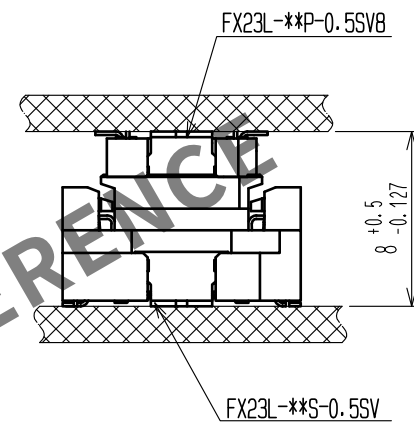


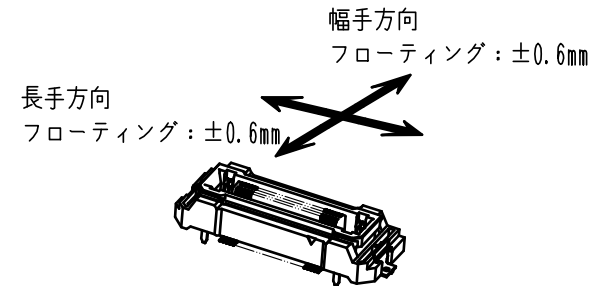
Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



7 基板間設定 (No scale)



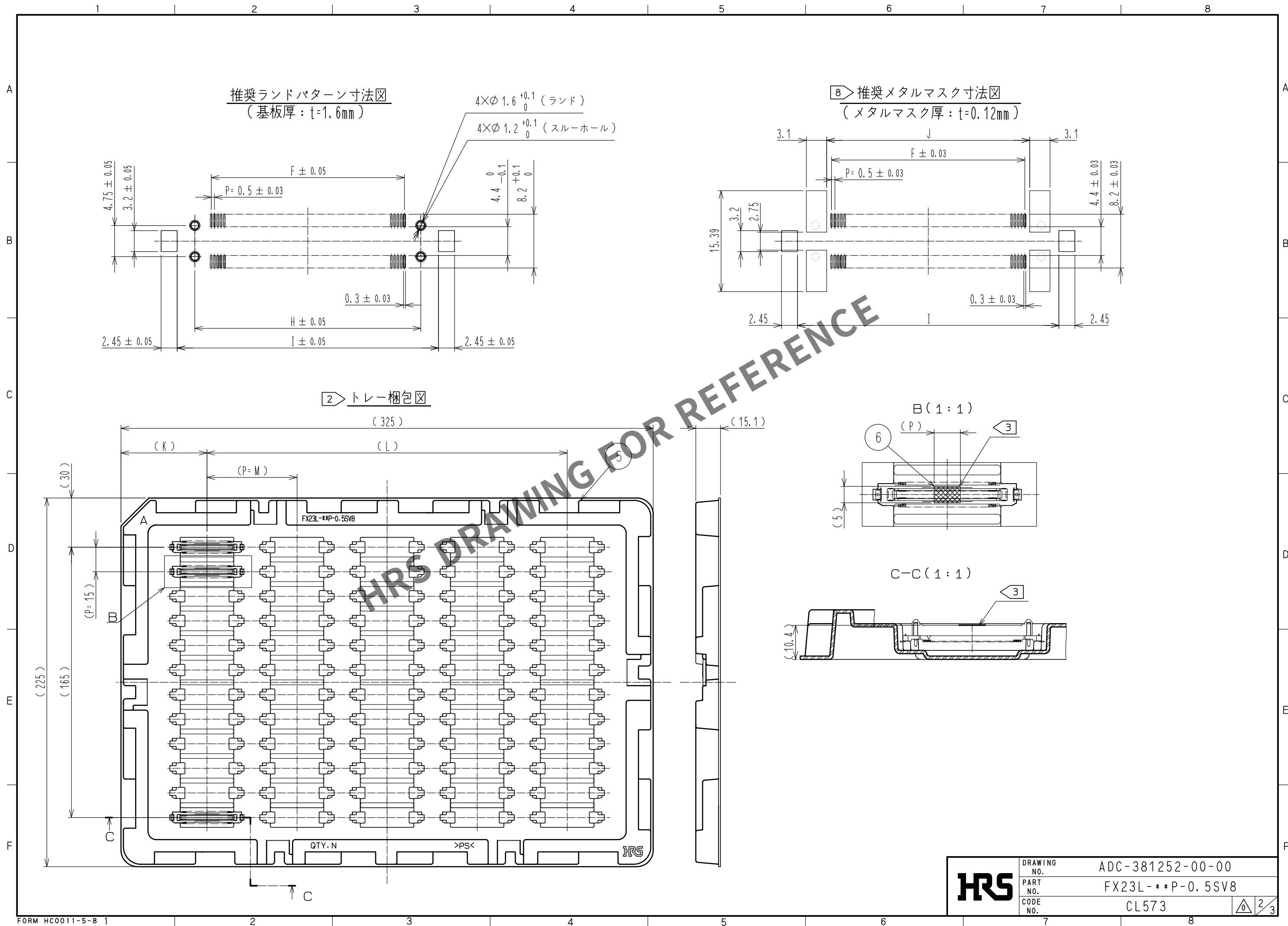
6 フローティング方向



製品名	HRS No.	極数	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N(入数)	P
FX23L-20P-0.5SV8	CL573-2001-5-00	20	18.7	17.2	4.5	11.65	9.5	14.9	6	40	245	35	96	4
FX23L-40P-0.5SV8	CL573-2002-8-00	40	23.7	22.2	9.5	16.65	14.5	19.9	11	50	225	37.5	84	8
FX23L-60P-0.5SV8	CL573-2003-0-00	60	28.7	27.2	14.5	21.65	19.5	24.9	16	50	225	45	72	8
FX23L-80P-0.5SV8	CL573-2004-3-00	80	33.7	32.2	19.5	26.65	24.5	29.9	21	50	225	45	72	8
FX23L-100P-0.5SV8	CL573-2005-6-00	100	38.7	37.2	24.5	31.65	29.5	34.9	26	52.5	220	55	60	8
FX23L-120P-0.5SV8	CL573-2006-9-00	120	43.7	42.2	29.5	36.65	34.5	39.9	31	52.5	220	55	60	8

- 注 1 SMTリード先端部における平坦度はMAX0.1とします。
2 本製品の納入形態はトレイ梱包とします。
3 本製品の吸着スペースを示します。吸着テープはコネクタを嵌合する前に必ず取り外してください。
4 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
5 ()内寸法は、参考値とします。
6 嵌合相手のフローティング量は±0.6mm MAXです。
なお、フローティング可動操作の繰返し回数はコネクタ挿抜回数に準じます。
7 基板間は指定の寸法内でご使用ください。
8 推奨メタルマスク寸法は弊社推奨ランドパターン寸法に実装することを前提としております。
また、本シリーズの電源端子ははんだペーストを周囲から引き込むタイプのスルーホールリフロー方式を採用しております。
コネクタ周囲の搭載部品によって推奨レイアウト通りにはんだペーストを塗布できない場合は、
弊社販売窓口までご相談くださいますようお願い致します。

2	銅合金	接触部: 金めっき 0.1μm	6	ポリイミド	(吸着テープ)
		実装部: 金めっき 0.03μm	5	ポリスチレン樹脂	(梱包トレイ)
		下地: ニッケルめっき 1.3μm	4	黄銅	純すずめっき 1μm
1	ポリアミド樹脂	黒	3	銅合金	接触部: 金めっき 0.1μm
NO. MATERIAL		FINISH, REMARKS		NO. MATERIAL	
UNITS mm		SCALE 2:1	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	
HRS		APPROVED: MK. NAGATA	20220819	DRAWING NO. ADC-381252-00-00	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CHECKED: MK. NAGATA	20220819	PART NO. FX23L-**-P-0.5SV8	
		DESIGNED: TS. MIYAKI	20220819	CODE NO. CL573	
		DRAWN: TS. MIYAKI	20220819		



HRS

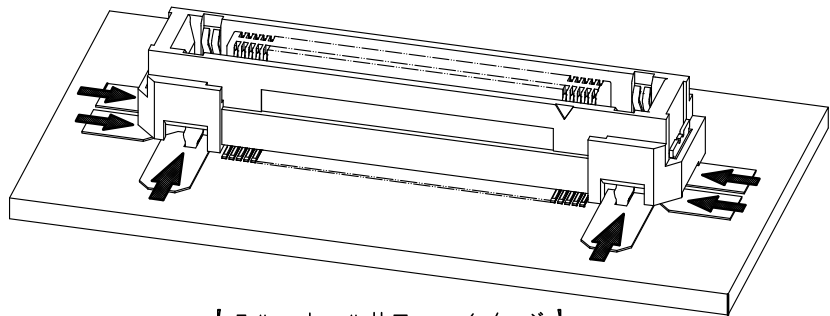
DRAWING NO.	ADC-381252-00-00
PART NO.	FX23L-**P-0.5SV8
CODE NO.	CL573

Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

本コネクタの破損や接触不良（嵌合不良など）を防ぐ為、以下の内容をご確認の上ご使用ください。

【基板実装】

本コネクタの電源端子や補強金具などのDIP部は、周囲からはんだペーストを引き込むスルーホールリフロー工程を採用しております。はんだペースト印刷エリアは銅箔ベタ(レジスト有り)または銅箔抜きフラット面としてください。スルーホールへのはんだ流入経路上にパターンやVIAホールなどのフラット面を損なう形状がある場合、はんだペーストをうまく引き込むことが出来ず、ボール状のはんだが基板面に残る可能性があり、未はんだの原因となる恐れがあります。

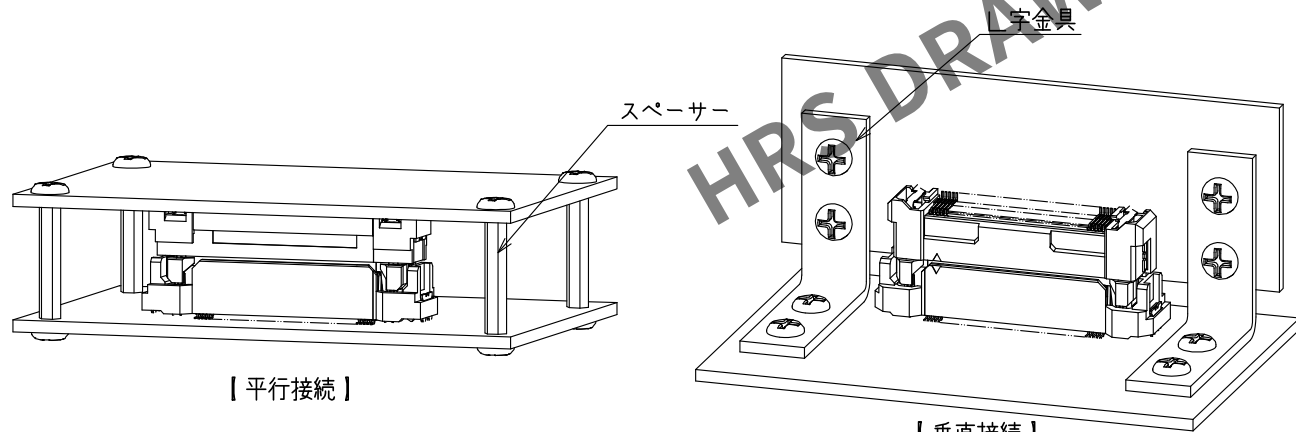


【スルーホールリフローイメージ】

実装側にはんだ印刷することが出来ず、やむを得ず裏面からはんだを供給する場合、はんだがうまくスルーホールへ流れこまず、電源端子との接続が不十分となる場合がございます。実装後にスルーホール内にはんだが十分に充填していることを基板の表面から確認するようお願い致します。

【基板固定】

本コネクタのフローティング機構は位置ずれを吸収することを目的としたものであり、振動や衝撃を吸収する機能は有しておりません。固定対策を行わずコネクタのみで基板を支えた場合、コネクタに過度の負荷がかかり、コネクタの破損や接触不良の原因となる恐れがありますので、必ず下図のようにコネクタ以外で基板が動かないように基板固定対策を行ってください。



なお、スペーサーをコネクタから離れた箇所に設置する場合、スペーサーをねじ止めするのみでは基板のたわみ等が影響し、コネクタが完全に嵌合されない可能性があります。コネクタを確実に嵌合させた後、スペーサーを固定するようにしてください。

【デザインガイドラインについて】

本製品の製品特徴及びお取り扱い方法に関するの情報提供を目的として、詳細な取扱説明書(ATAD-F0887-00)を別途用意しておりますので、必要に応じて弊社営業窓口にお問合せいただけますよう、よろしくお願い致します。

HRS

DRAWING NO.	ADC-381252-00-00
PART NO.	FX23L-**P-0.5SV8
CODE NO.	CL573

3/3